

<<微系统封装基础>>

图书基本信息

书名：<<微系统封装基础>>

13位ISBN编号：9787810894197

10位ISBN编号：7810894196

出版时间：2005-1

出版时间：东南大学出版社

作者：图马拉

页数：888

字数：1107000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微系统封装基础>>

内容概要

本书是国际上第一本微系统封装的参考书。

内容包括：微电子、光子、RF、MEMS的基础知识；微系统单芯片、多芯片、圆片级封装技术；IC装配技术、电路版装配技术及封装材料；微系统封装的电性能、热性能、可靠性设计；同时介绍了微系统的主要应用领域。

本书内容从基础开始，系统全面地介绍了微系统封装技术。

适合微电子、光子、RF通信和MEMS等相关专业高年级本科生、研究生、教师阅读，也合适相关科研人员 and 工程技术人员作为专业参考书。

<<微系统封装基础>>

作者简介

Rao R. Tummala是佐治亚理工学院封装研究中心的教授和创立者。他加入佐治亚理工学院以前，一直在IBM从事封装研究工作，首先将低温共烧陶瓷（LICC）和多芯片组件等技术用于工业生产，并成为IBM FOLLOW。

Tummala教授发表学术论文270余篇，拥有68项美国发明专利，并于

<<微系统封装基础>>

书籍目录

1 微系统封装导论 1.1 微系统概述 1.2 微系统技术 1.3 微系统封装 (MSP) 概述 1.4 微系统封装的重要性 1.5 系统级微系统技术 1.6 对微系统工程师的期望 1.7 微系统及封装技术发展史 1.8 微系统及封装技术发展史 1.9 练习题 1.10 参考文献2 封装在微电子中的作用 2.1 微电子概述 2.2 半导体的特性 2.3 微电子器件 2.4 集成电路 (IC) 2.5 IC封装 2.6 半导体技术发展路线图 2.7 IC封装的挑战 2.8 总结及发展趋势 2.9 练习题 2.10 参考文献3 封装在微系统中的作用 3.1 电子产品概述 3.2 微系统剖析 3.3 计算机与因特网 3.4 封装在计算机工业中的作用 3.5 封装在电信工业中的作用 3.6 封装在汽车系统中的作用 3.7 封装在医疗电子中的作用 3.8 封装在消费类电子产品中的作用 3.9 封装在MEMS产品中的作用 3.10 总结及发展趋势 3.11 练习题 3.12 参考文献4 电气性能的封装设计基础5 可靠性设计基础6 热控制基础7 单芯片封装基础8 多芯片封装基础9 IC组装基础10 圆片级封装基础11 分立、集成和嵌入的无源元件基础12 光电子基础13 射频封装基础14 微机电系统 (MEMS) 基础15 密封与包封基础16 系统级印刷电路板基础17 电路板组装基础18 封装材料与工艺基础19 电气性能测试基础20 封装制造基础21 微系统的环境设计基础22 微系统可靠性概述术语汇总表附录

<<微系统封装基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>